

YS-LD 语音模块使用手册

一、模块与单片机的连接方式

本芯片为 3.3V 供电与其连接的单片机必须为 3.3V 供电的单片机，从而保证 IO 口电平不超过 3.3V，否则将导致语音芯片驱动不成功甚至导致语音芯片烧坏，以下为该模块的 2 种驱动方式的端口连接；（模块管脚定义请查看“YS-语音识别模块说明手册.PDF”）

1、并口方式

→

LD_P0--LDP7 (8位并行数据、地址端口)
LD_A0 (1: LD_P0-LD_P7为地址端口, 0: LD_P0-LD_P7为s
数据端口)
LD_CS (芯片片选端口)
LD_WR (芯片写端口)
LD_RD (芯片读端口)
LD_IRQ (中断信号, 模块收到声音后产生一个下降沿)
LD_Reset (芯片复位端口)

2、SPI 方式

→

LD_P0->SDI (SPI 输入端口)
LD_P1->SDO (SPI 输出端口)
LD_P2->SDCLK (SPI 时钟端口)
LD_WR->SPIS (SPI 片选端口)
LD_Reset (芯片复位端口)
LD_IRQ (中断信号, 模块收到声音后产生一个下降沿)
LD_CS (芯片片选端口, 低电平有效)

二、程序移植调试步骤

1、程序移植：根据自己的单片机使用情况，移植配套程



序，

其中“LDChip.c”程序文

件为 LD3320 芯片的驱动函数；“Reg_RW.c”为读写函数，该读写函数是通用的，可以读写即可。

2、在移植过程中注意不要修改“LDChip.c”中寄存器的配置和初始化函数，用户需要修改“Reg_RW.c”端口定义、读写函数、“LDChip.h”中的时钟宏定义 CLK 实际输入多少 则修改为多少、根据晶振情况修改延时函数。


3、做好电路连接和移植好程序端口后查看配套的资料


“LD3320 芯片简明调试步骤.pdf” 进行程序调试。

（特别说明：LD3320 芯片的调试存在一定的难度，根据单片机基础的水平耐 心调试时间在 1-15 天不等，只要保证连接电路正确程序耐心根据步骤调试 会很快得到效果。）

三、关于配套的其他资料说明

本模块配套的资料相对比较多，为了不让用户混乱无从下

手，我们建议先查看  该资料包的相关内容进行操作，在开发过程中遇到部分寄存器需要了解或其他不明白

的地方可以继续参考  这 LD3320 的芯片开发资料，这主要关于底层驱动的开发。如果我们用的驱动芯片是 51 或者 STM32 就已经配套有程序，无需再看那些资料，好好根据以上步骤进行移植即可。

四、其他说明

对于单片机基础不扎实，什么叫做移植程序、什么是主函数、串口等都没弄明白的用户请先打好基础后在进行调试。或联系本店客服购买一体化自带单片机-免驱动的语音识别模块。